

THERMAL SYSTEMS

Neue Anwendungsmöglichkeiten mit ProtectoXP

Von Dam & Fill bis zur Dichtraupe – individuell und punktgenau

**Jetzt
noch
flexibler!**



ProtectoXP
Coating

Mehr als „nur“ Lackieren

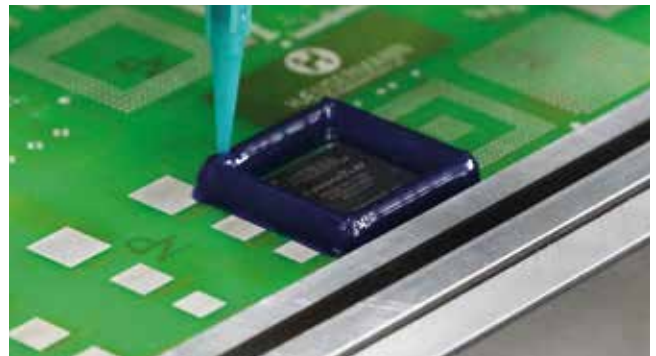
Anwendungsmöglichkeiten mit ProtectoXP

Mit der ProtectoXP ergeben sich völlig neue Anwendungsfelder – auch außerhalb des Conformal Coating Bereichs. Durch den hochflexiblen Anlagenbau können Sie mit Hilfe der ProtectoXP gleich mehrere Prozesse innerhalb einer Maschine vereinen. Neben der Versiegelung der gesamten Platine können auch nur Teilbereiche oder einzelne Bauteile auf dem Träger vergossen werden. Vom „Globe Top“ über

„Dam & Fill“ bis zum „Flip Chip Underfill“ haben sich hier unterschiedliche Verfahren herausgebildet. Mit der ProtectoXP kann eine Vielzahl an Anwendungen – allesamt in einer Anlage – realisiert werden. Der Bediener kann dabei mit innovativer Düsenteknologie verschiedenste Materialien auf die Baugruppe auftragen – so ist später jedes Produkt genau den Anforderungen entsprechend optimal geschützt.

Dam & Fill

Durch Dam & Fill lassen sich einzelne Bereiche auf der Leiterplatte selektiv vergießen und dadurch sehr effizient schützen. Es werden hierzu zwei Materialien mit unterschiedlicher Viskosität verwendet. Zunächst wird mit einem hochviskosen Material ein Damm um das zu schützende Bauteil gelegt. Anschließend wird der Bereich innerhalb des Damms mit einem niederviskosen Material aufgefüllt.



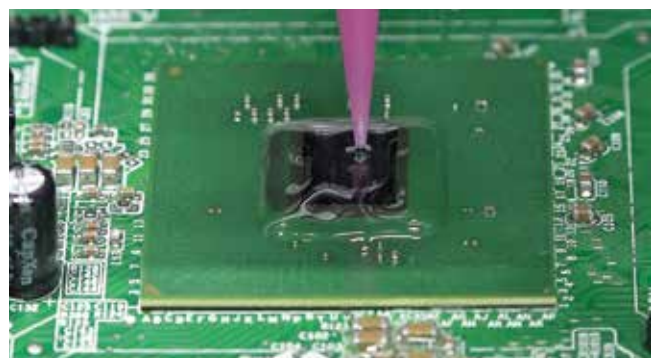
Dichten

Bei diesem Prozess wird ein 1K oder 2K Material so auf einem Bauteil aufgetragen, dass sich eine kontinuierliche und gleichmäßige Dichtraupe ergibt. Hierfür eignen sich besonders volumetrisch arbeitende Applikatoren.



Globe Top

Ein Globe Top dient zum Schutz eines selektiven Bereiches auf der Leiterplatte. Hierzu wird ein Material verwendet, welches einerseits fließfähig genug ist, um alle beteiligten Bauteile sicher zu verkapseln, aber auf der anderen Seite nicht so niedrigviskos ist, dass es auf benachbarte Bauteile verfließt.



Flip Chip Underfill

Underfills steigern die mechanische Stabilität zwischen dem Chip und der Leiterplatte und verteilen lokal auftretende Spannungen über eine größere Fläche, was die Lebensdauer deutlich erhöht. Hierzu wird ein niederviskoses Material am Randbereich des Chips entlang appliziert, welches dann selbstständig, durch den Kapillareffekt, den Spalt zwischen Chip und Leiterplatte füllt.



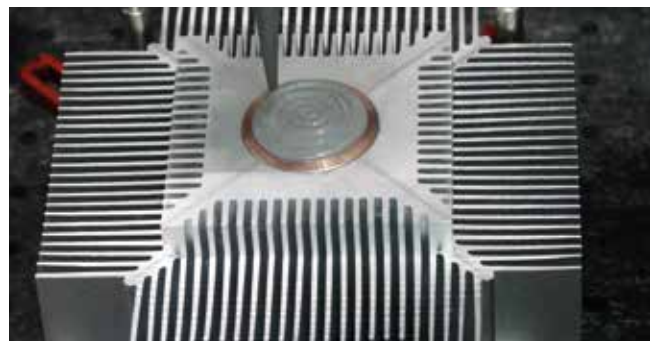
1K und 2K Verguss

Ein Verguss wird immer dann angewendet, wenn eine besonders hohe Schutzwirkung nötig ist. Dank der volumetrisch arbeitenden Applikatoren ist sichergestellt, dass immer exakt die gleiche Materialmenge im richtigen Mischungsverhältnis, unabhängig von Temperatur und Druckschwankungen, bereitgestellt wird.



Wärmeableitung

Durch die stetige Miniaturisierung in der Elektronik steht immer weniger Oberfläche für die Wärmeableitung zur Verfügung. Umso wichtiger ist ein optimaler Übergang zwischen Kühlkörper und Bauteil. Flüssige Wärmeleitmedien können sich besser als etwa feste Pads oder Folien an die individuellen Konturen anpassen und gewährleisten eine sichere Wärmeabfuhr, was die Lebensdauer der Bauteile deutlich erhöht.



Individuelle Anforderungen

Sie suchen einen Partner, der Ihnen eine Komplettlösung für Ihren Lackier- und Dispensprozess anbieten kann? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Dank vielseitiger Applikatoren und Fördereinheiten können wir bereits heute viele Anforderungen mit unseren Standardanwendungen erfüllen. Gerne sind wir aber auch bereit, neue Herausforderungen anzugehen und für Sie in einen serienreifen Prozess umzusetzen.





THERMAL SYSTEMS



Rehm Worldwide

Als führender Hersteller von innovativen thermischen Systemlösungen haben wir Kunden auf allen Kontinenten. Mit eigenen Standorten in Europa, Amerika und Asien sowie 26 Vertretungen in 24 Ländern können wir die internationalen Märkte schnell bedienen und bieten exzellenten Service vor Ort – weltweit und rund um die Uhr!

- Standort
- Produktionsstandort
- Vertretung



Rehm Thermal Systems GmbH

Leinenstrasse 7
89143 Blaubeuren, Germany

T +49 73 44 - 96 06 0 | F +49 73 44 - 96 06 525
info@rehm-group.com | www.rehm-group.com